

平成 30 年 1 月 25 日

各 位

住 所 横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号  
会 社 名 ジオマテック株式会社  
代 表 者 代表取締役社長兼 CEO 松崎 建太郎  
( J A S D A Q コード : 6907 )  
問 合 せ 先 取締役執行役員兼 CFO 河野 淳  
電 話 番 号 045-222-5720

三井金属鉱業株式会社が開発したファンアウト・パネルレベルパッケージ用  
ガラスキャリア付き微細回路形成用材料「HRDP<sup>®</sup>」への薄膜提供に関するお知らせ

当社は、三井金属鉱業株式会社（代表取締役社長 西田計治）が開発した、ファンアウト・パネルレベルパッケージ<sup>※1</sup>用ガラスキャリア付き微細回路形成用材料「HRDP<sup>®</sup>」<sup>※2</sup>に使用される薄膜の量産技術を確立し、提供することとなりましたのでお知らせいたします。

三井金属鉱業株式会社（以下、三井金属）は、IoT 時代の高い要求性能に新たな技術革新で対応するためファンアウト・パネルレベルパッケージ向けに「HRDP<sup>®</sup>」を開発しました。当社は、「HRDP<sup>®</sup>」に使用される機能性が高い多層薄膜の量産技術を確立し、三井金属に提供することとなりました。当社は、三井金属と共創・協働し、価値ある薄膜と加工技術を提供するプロフェッショナルとしてお客様への十分な供給能力を確保してまいります。

以 上

ご参考

【三井金属鉱業株式会社】（2017 年 3 月末現在）

所在地：東京都品川区大崎 1-11-1

代表取締役社長：西田 計治

資本金：421 億 2,946 万円

従業員数：11,630 名（連結）、1,739 名（単体）

事業内容：機能材料・電子材料の製造・販売、非鉄金属製錬、資源開発、貴金属リサイクル、  
素材関連事業、自動車部品の製造・販売 等

本件に関するお問い合わせ

三井金属鉱業株式会社 経営企画本部 広報部  
TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029  
E メールアドレス [PR@mitsui-kinzoku.co.jp](mailto:PR@mitsui-kinzoku.co.jp)

ジオマテック株式会社

TEL 045-222-5720 FAX 045-222-5735  
E メールアドレス [ir.geomatec@geomatec.co.jp](mailto:ir.geomatec@geomatec.co.jp)

## 【HRDP<sup>®</sup>の紹介】

「HRDP<sup>®</sup>」は、ガラスキャリア表面上に多層薄膜を形成した構造となっています（写真1、図1）。

その特徴は、高い平坦性を有するガラスキャリア上に形成された極薄の「メッキ用シード層」によって超微細な RDL<sup>※3</sup> をパネルサイズ（例 600×600 mm）で形成でき、また「剥離機能層」によって260°Cの熱負荷後でも安定な機械的ガラスキャリアの取り外しが可能になります。



写真1 「HRDP<sup>®</sup>」表面外観写真

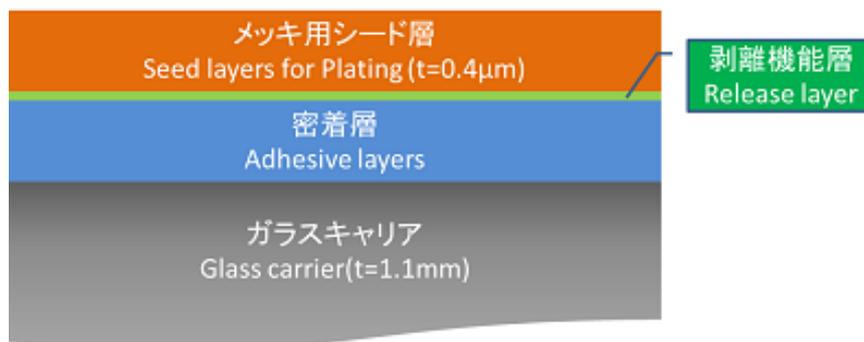


図1 「HRDP<sup>®</sup>」の断面構造模式図

## 【用語解説他】

- ※1 Fan Out Panel Level Package
- ※2 High Resolution De-bondable Panel
- ※3 Re-Distribution Layer